



Amkor Technology (AMKR.US)

첨단 패키징 수요 강세, 관련 CapEx 상향 조정

- 3Q25CY 실적 기대치 상회, 4Q25CY 가이드는 시장 컨센서스 부합
- 4Q25CY iOS 진영의 계절적 수요 약세를 예상하고 있기 때문
- 첨단 패키징의 수요 증가와 고객들의 투자 요구 확대를 반영해, 관련 CapEx 상향

3Q25CY 실적, 기대치 상회

3Q25CY 실적이 매출액 \$1.99B(+31%QoQ, +7%YoY)와 영업이익 \$0.16B(+73%QoQ, +6%YoY)를 기록하며, 시장 기대치(매출액 \$1.93B, 영업이익 \$0.14B)를 상회했다. 첨단 패키징에 대한 강력한 수요에 따라 Communications 와 Computing 부문의 매출액이 사상 최대치를 기록했기 때문이다. 또한 신규 착공에 나선 애리조나 첨단 패키징 공장은 2027년 중반에 1 단계 공사가 완료되고, 2028년 초에 초도 양산이 시작되며, 회사의 중장기 실적 성장에 기여할 것으로 기대되고 있다. 회사 측은 AI의 확산이 시장 확대와 기술 전환, 제조 기반 확충에 대한 요구를 이끌고 있어, 중장기 실적 성장이 밝다는 점을 강조했다.

4Q25CY 가이드는, 시장 컨센서스 부합

4Q25CY 가이드는 \$1.77~1.87B(-11%~-6%QoQ, +9~15%YoY)와 매출총이익률 +14~15%로 제시되며, 시장 컨센서스(매출액 \$1.82B, 매출총이익률 14.5%)에 대체로 부합했다. 매출 비중 46%를 차지하고 있는 Communications 의 계절적 비수기 영향이 예상되고, 21%를 차지하고 있는 Computing 부문 역시 제품 mix 변화에 따른 실적 감소가 예상된다. Communications 의 경우 iOS 진영의 계절적 수요 둔화 영향이 Android 부문의 성수기 효과를 상쇄할 전망이다.

첨단 패키징 수요에 대한 자신감

Amkor 는 이번 컨퍼런스 콜을 통해 2025년 CapEx 와 애리조나 신규 공장 증설에 대한 총 CapEx 를 상향 조정했다. 투자자들 역시 해당 상향 조정의 근거에 대한 관심을 보였는데, Amkor 는 이에 대해 "첨단 패키징에 대한 수요 증가와 고객들의 투자 요구 확대" 때문이라고 언급했다. 또한 첨단 패키징과 관련돼 일부 제품 군의 tight 한 수급 상황이 예상되고, 기판과 같은 부품의 공급 제약이 발생 중이라고 언급해, 서플라이 체인 전반의 공급 확대가 필요해 보인다.

▶ 현재주가 / 목표주가 컨센서스

현재주가('25.11.05): \$36.55
 목표주가 컨센서스: \$35.83

▶ 투자 의견 컨센서스

매수	보유	매도
58%	33%	8%

Stock Data

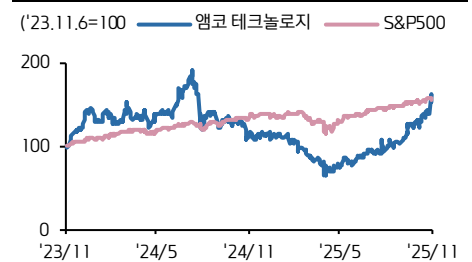
산업분류	반도체 & 반도체 장비
S&P 500 (11/05)	6,796.29
현재주가/목표주가	36.55 / 35.83
52주 최고/최저 (\$)	38.22 / 14.03
시가총액 (백만\$)	9,035
유통주식 수 (백만)	110
일평균거래량 (3M)	2,715,226

Earnings & Valuation

(백만 \$)	FY23	FY24	FY25E	FY26E
매출액	6,503	6,318	6,653	7,260
영업이익	470	438	425	554
OPM(%)	7.2	6.9	6.4	7.6
순이익	360	354	311	420
EPS	1.5	1.4	1.3	1.7
증가율(%)	-53.1	-2.1	-12.3	32.7
PER(배)	22.5	18.0	29.2	22.0
PBR(배)	2.0	1.5	2.1	1.9
ROE(%)	9.4	8.7	7.1	9.2
배당수익률(%)	0.9	1.2	1.0	1.2

Performance & Price Trend

주가수익률 (%)	YTD	1M	6M	12M
절대	42.3	24.4	105.7	41.0
S&P Index	15.1	0.8	19.1	18.5



자료: 데이터 스트림 컨센서스, 키움증권 리서치센터

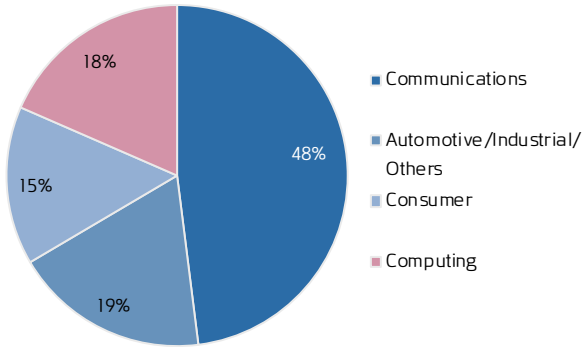
Amkor Technology 실적 추이 및 전망 (단위: 백만달러)

	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25E	2024	2025	2026E
매출액	1,366	1,461	1,862	1,629	1,322	1,511	1,987	1,833	6,318	6,653	7,278
%QoQ/%YoY	-22%	7%	27%	-12%	-19%	14%	31%	-8%	-3%	5%	9%
Communications	642	702	968	717	529	605	1,013	884	3,028	3,030	3,285
%QoQ/%YoY	-35%	9%	38%	-26%	-26%	14%	68%	-13%	-7%	0%	8%
Automotive/Industrial/Others	300	292	298	277	278	302	318	328	1,168	1,226	1,347
%QoQ/%YoY	-10%	-3%	2%	-7%	0%	9%	5%	3%	-16%	5%	10%
Consumer	191	175	298	293	225	272	278	254	958	1,028	1,050
%QoQ/%YoY	-9%	-8%	70%	-2%	-23%	21%	2%	-9%	14%	7%	2%
Computing	232	292	298	342	291	333	378	364	1,164	1,365	1,509
%QoQ/%YoY	2%	26%	2%	15%	-15%	14%	14%	-4%	14%	17%	11%
매출원가	1,164	1,249	1,589	1,382	1,164	1,329	1,702	1,567	5,384	5,763	6,232
매출원가율	85%	85%	85%	85%	88%	88%	86%	85%	85%	87%	86%
매출총이익	202	212	272	247	158	182	284	266	933	890	1,045
판매비와관리비	90	91	81	69	80	48	83	81	332	293	336
영업이익	73	82	149	134	32	92	159	143	438	425	564
%QoQ/%YoY	-54%	11%	83%	-10%	-77%	192%	73%	-10%	-7%	-3%	33%
영업이익률	5%	6%	8%	8%	2%	6%	8%	8%	7%	6%	8%
법인세차감전순이익	72	82	142	136	26	83	154	135	431	398	541
법인세비용	13	15	19	30	5	29	28	27	77	88	108
당기순이익	59	67	123	106	21	54	127	108	354	310	433
당기순이익률	4%	5%	7%	6%	2%	4%	6%	6%	6%	5%	6%
CapEx	96	166	196	286	80	146	246	480	744	953	1,084
%QoQ/%YoY	-60%	73%	18%	46%	-72%	83%	69%	95%	-1%	28%	14%
감가상각비	145	150	151	149	154	159	164	174	595	650	703
%QoQ/%YoY	-9%	3%	0%	-1%	3%	3%	3%	6%	-6%	9%	8%

주: 실적 전망치는 Bloomberg 컨센서스 기준 (기준일: 2025/11/05). 실적은 Non-GAAP, CY 기준

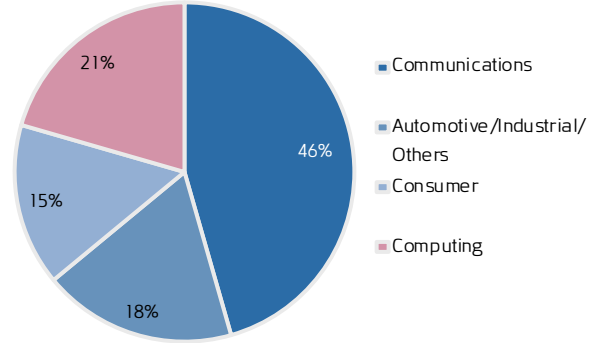
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024CY Amkor Technology 매출액 비중



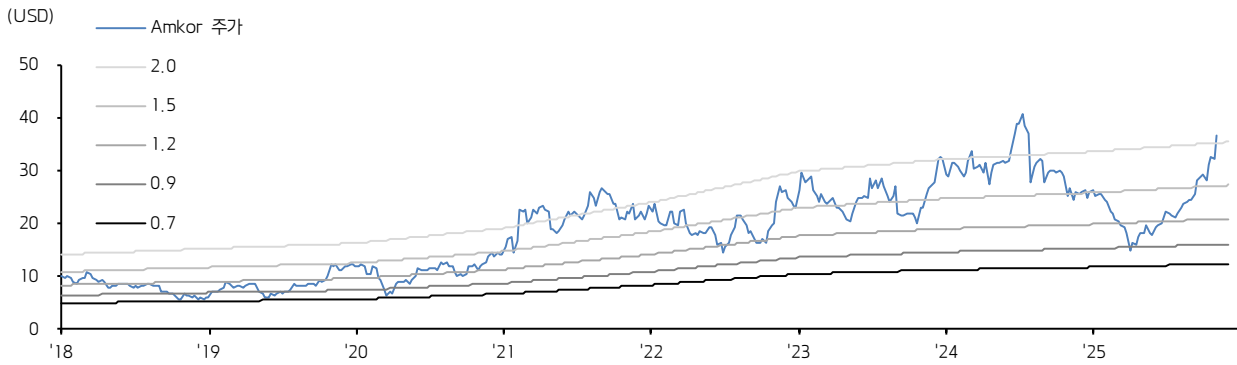
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2025CY Amkor Technology 매출액 비중 전망



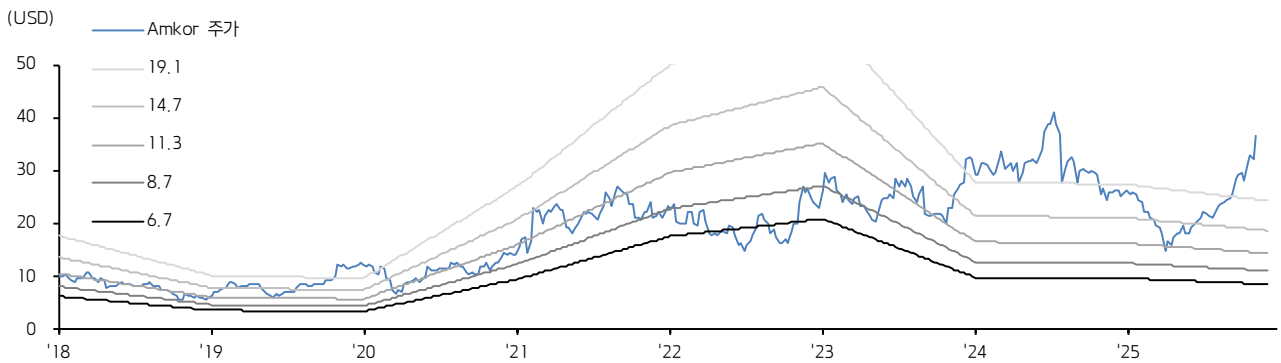
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Amkor Technology 12개월 Trailing P/B Chart



주: 11/05 종가 기준
자료: 키움증권 리서치센터

Amkor Technology 12개월 Trailing P/E Chart



주: 11/05 종가 기준
자료: 키움증권 리서치센터

글로벌 Tech 기업 추가 및 Valuation

(십억달러, 백, %)		Mkt Cap	%CHG				P/E		P/B		EV/EBITDA		Rev		OP		EBITDA		ROE		
		ID	5D	1M	3M	6M	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	
Memory	Micron	266.6	8.9	4.8	26.4	117.8	195.3	21.3	12.6	4.4	3.3	11.4	7.5	43.1	58.4	14.0	25.5	23.6	34.6	21.4	28.4
	Sandisk	31.7	11.3	5.9	68.6	416.3	525.5	82.1	20.4	3.3	2.9	39.4	14.9	8.1	10.2	-1.3	2.4	0.8	2.1	-1.1	17.3
	Kioxia	36.9	-2.0	12.4	66.9	352.0	477.8	33.0	10.5	6.2	4.6	8.9	5.7	11.8	14.6	2.0	5.1	4.8	6.6	32.0	39.1
	Seagate	58.9	10.1	3.8	9.1	81.7	194.7	27.9	21.3	645.1	44.6	20.9	15.1	9.8	11.8	2.5	3.8	2.9	4.0	255.3	515.9
	Western Digital	54.7	5.2	13.2	21.9	111.1	255.5	23.9	19.0	8.5	6.5	16.3	12.0	10.4	12.5	3.2	4.1	3.4	4.5	36.1	90.3
	Nanya	13.8	4.9	3.8	66.3	218.3	289.8	841.5	15.2	2.6	2.2	28.4	7.5	2.0	3.5	-0.0	1.1	0.5	1.6	0.4	16.2
Logic	Intel	178.5	3.6	-7.2	4.2	90.1	89.3	112.2	61.0	1.6	1.6	15.7	12.5	52.6	53.7	2.5	4.6	13.7	16.0	0.7	1.8
	Nvidia	4,743.6	-1.8	-5.7	4.0	9.5	71.5	43.4	29.9	33.6	18.9	35.3	23.9	200.6	283.6	121.4	189.4	132.8	192.0	92.5	77.2
	AMD	417.3	2.5	-3.0	55.7	47.1	154.8	64.6	39.9	6.8	6.1	56.5	35.0	34.1	43.5	7.3	11.7	8.1	12.1	8.7	12.8
	Broadcom	1,695.2	2.0	-7.0	6.1	22.5	78.8	51.8	36.3	21.4	16.5	39.6	28.3	65.5	91.1	33.3	59.8	43.7	60.3	42.3	48.1
	Marvell	80.1	6.1	3.1	7.7	21.2	49.9	33.9	27.9	5.5	5.2	26.1	22.3	8.0	9.3	1.9	3.4	3.1	3.6	5.3	3.5
	Qualcomm	193.9	4.0	0.6	6.2	22.5	28.9	15.1	14.9	6.7	6.0	12.2	11.7	44.2	44.5	10.2	15.1	16.1	16.4	44.2	39.9
	Arm	169.7	-0.3	-6.0	4.9	16.7	31.4	97.6	73.4	21.5	17.0	79.7	57.4	4.5	5.6	1.3	2.6	2.1	2.9	17.5	20.5
	Skyworks	10.9	2.0	-6.7	-4.7	8.6	11.1	12.8	16.4	1.9	2.1	7.6	9.2	3.9	3.7	0.5	0.7	1.3	1.1	8.2	9.0
	TI	148.6	2.6	2.1	-9.3	-11.8	0.7	28.8	26.1	9.1	8.7	19.8	17.3	17.7	19.1	6.0	6.7	8.0	9.1	31.1	35.1
	ADI	116.1	2.9	0.4	-2.5	6.9	19.4	29.0	24.4	3.4	3.3	20.1	17.9	11.3	12.6	3.8	5.7	6.0	6.8	9.2	11.8
	NXP	53.0	2.9	2.8	-8.1	0.9	13.8	17.9	15.3	5.2	4.6	13.3	11.5	12.2	13.4	4.1	4.6	4.6	5.2	29.2	31.2
	STMicro	21.4	2.5	-2.8	-16.6	-3.8	4.5	38.6	21.5	1.2	1.2	8.2	5.8	11.7	12.5	0.4	1.1	2.3	3.2	3.0	5.5
	Microchip	32.8	2.2	-2.8	-8.6	-9.4	27.2	54.7	26.3	5.3	5.1	28.9	17.6	4.4	5.3	0.5	1.7	1.4	2.2	7.6	18.2
	On Semi	20.2	3.7	-2.6	1.6	6.0	30.4	21.5	17.2	2.6	2.5	12.1	11.2	6.0	6.3	1.1	1.3	1.7	1.8	10.1	14.7
	Silicon Motion	3.4	7.0	-1.8	-0.1	32.1	87.4	27.7	20.7	3.8	3.5	21.5	13.9	0.9	1.0	0.1	0.2	0.1	0.2	13.5	17.4
	Mediatek	69.0	1.1	2.3	0.8	0.8	3.9	20.1	18.3	5.3	4.9	15.2	13.9	19.2	21.3	3.4	3.8	4.2	4.5	26.8	28.8
Renesas	22.5	-4.3	-3.4	2.0	3.6	6.8	10.7	9.3	1.4	1.3	12.3	9.5	8.5	9.2	1.1	1.6	2.4	2.9	-0.2	10.0	
Novatek	7.7	-0.6	-2.4	-6.0	-14.1	-24.6	14.6	12.6	3.7	3.4	9.4	8.6	3.3	3.5	0.6	0.7	0.7	0.7	24.8	27.9	
Foundry	TSMC	1,523.0	-0.1	-3.8	0.5	26.3	66.5	28.5	24.3	8.8	7.0	17.4	14.3	122.5	149.2	60.9	73.7	84.3	101.0	33.3	32.3
	SMIC	88.9	-0.2	-10.5	-21.3	36.3	52.7	103.6	72.0	3.4	3.0	23.8	20.1	9.3	11.0	0.8	1.2	4.5	5.4	3.3	4.5
	UMC	19.5	2.1	5.0	7.0	14.0	4.9	19.4	17.3	7.8	7.4	N/A	N/A	7.6	8.1	1.4	1.5	3.3	3.7	10.5	11.4
	GFS	19.8	3.5	3.7	-0.5	8.6	-0.7	22.3	17.7	1.7	1.6	7.9	6.9	6.8	7.3	1.0	1.6	2.3	2.5	7.9	9.0
	VIS	5.8	-2.7	-3.0	-5.4	-0.6	8.6	22.2	20.9	2.6	2.5	10.4	10.3	1.6	1.7	0.3	0.3	0.5	0.6	12.1	12.9
Packaging	ASE	35.0	3.0	9.7	42.9	62.7	74.5	32.9	21.9	5.9	5.5	N/A	N/A	20.7	23.6	1.6	2.4	3.7	4.7	11.3	14.0
	Amkor	9.0	3.7	11.8	24.4	64.9	105.7	29.1	22.0	2.1	1.8	8.3	7.2	6.7	7.3	0.4	0.6	1.1	1.3	7.1	9.1
	Agilent	41.6	0.5	2.5	3.6	27.7	35.4	26.0	24.1	6.1	5.5	21.3	19.6	7.0	7.3	1.6	2.0	2.0	2.2	24.4	23.4
	Chipbond	1.4	-0.5	-1.2	5.8	8.6	-6.1	14.0	14.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.7	0.7	0.1	0.1	0.2	0.2	6.7	6.8
Equipment	ASML	405.1	1.3	-2.5	1.1	51.3	52.7	37.0	35.1	17.5	14.7	28.2	26.9	37.4	39.2	12.9	13.5	14.1	14.7	49.6	45.1
	AMAT	191.9	4.6	2.2	10.7	34.5	55.8	26.1	24.7	9.8	8.9	21.7	20.5	28.0	29.7	8.4	8.8	8.8	9.2	37.5	37.1
	LAM Research	207.3	6.0	2.7	13.2	70.7	123.3	34.4	32.2	19.2	15.4	28.1	25.9	20.5	22.3	6.9	7.5	7.3	7.9	57.2	59.4
	TEL	102.1	-4.1	6.1	9.2	54.8	57.9	29.6	26.8	7.7	7.0	20.5	17.5	15.9	16.7	4.3	4.5	4.7	5.6	26.0	25.8
	KLA	161.2	2.8	-0.7	11.4	38.9	77.0	34.6	31.5	30.5	24.4	27.5	25.7	12.7	13.9	5.4	6.0	5.9	6.3	93.2	83.8
	AMEC	25.8	0.2	-1.1	-1.8	49.7	55.4	85.1	57.5	8.4	7.4	80.4	51.5	1.7	2.2	0.3	0.5	0.3	0.5	10.1	13.2
	Naura	40.3	-2.1	-6.3	-12.3	19.7	17.1	39.1	29.3	7.4	6.0	31.4	23.0	5.5	7.0	1.1	1.5	1.3	1.7	19.7	21.3
Materials	Linde	195.1	-0.3	-2.5	-8.4	-10.2	-9.1	25.4	23.4	5.0	4.7	16.2	15.2	33.9	35.6	10.0	10.7	13.4	14.2	19.5	20.3
	Air Liquid	112.3	0.0	-0.4	-1.6	-2.4	-8.2	25.7	23.2	3.4	3.2	13.1	12.1	31.4	32.7	6.6	7.2	9.4	10.2	14.0	14.7
	Air Products	52.9	-1.3	-4.3	-12.5	-18.8	-12.7	19.4	18.0	3.0	2.8	13.5	12.7	12.2	12.8	0.0	3.3	5.2	5.5	16.0	16.1
	Merck KGaA	55.2	-2.0	-3.9	-8.6	2.4	-12.1	13.2	12.8	1.5	1.4	9.3	8.8	24.5	25.2	4.4	4.6	6.9	7.1	10.8	10.3
	ADEKA	2.4	-1.7	1.2	4.6	15.2	33.2	14.7	15.4	1.2	1.1	6.2	8.1	2.8	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3	8.7	8.9
	Resonac	6.8	-3.8	-4.0	-4.0	56.2	111.6	34.0	14.7	1.6	1.4	10.8	8.1	8.9	9.2	0.4	0.7	1.1	1.4	4.7	10.6
	Siltronic	1.7	-2.6	-14.2	-7.4	36.9	32.0	N/A	N/A	0.8	0.8	9.0	6.9	1.5	1.7	-0.1	-0.1	0.4	0.5	-4.0	-5.4
Sumco	3.4	-8.3	-7.2	-14.2	23.2	47.6	N/A	311.6	0.9	0.9	7.0	5.5	2.7	2.9	-0.0	0.1	0.8	0.9	-1.1	0.4	
Server	Dell	103.0	-1.4	-6.8	8.3	16.8	61.5	16.2	13.6	N/A	239.4	10.5	9.4	106.6	116.4	8.1	10.6	11.7	12.9	-334.8	202.8
	HPE	31.3	0.6	-2.3	-2.9	19.3	42.2	12.3	9.7	1.3	1.2	8.0	6.3	35.9	41.3	1.1	4.7	6.0	7.2	11.1	12.2
	Lenovo	17.8	-1.6	-3.4	-3.0	1.1	20.5	13.3	10.9	2.6	2.2	5.4	4.2	75.9	81.3	2.6	2.9	3.4	4.2	24.0	23.6
	Quanta	36.2	0.7	-6.0	-3.5	0.3	14.0	16.1	13.7	5.2	4.7	11.8	10.3	69.8	92.0	2.8	3.3	3.2	3.8	31.0	33.6
	Inspur	12.9	0.3	-11.6	-16.0	13.1	19.6	34.3	25.8	4.1	3.6	30.8	22.7	21.9	27.3	0.4	0.5	0.4	0.6	12.2	13.9
	Wiwynn	25.0	-3.1	1.3	20.2	50.1	96.0	17.2	15.3	6.8	5.9	12.0	11.0	28.3	35.2	1.9	2.1	2.0	2.3	44.2	40.8
	Inventec	5.1	-1.7	-8.4	-4.8	-0.9	5.4	18.8	15.2	2.3	2.2	11.4	11.0	22.2	24.0	0.4	0.5	0.6	0.6	11.9	13.7
	Mitac	4.1	-1.6	-0.4	4.9	27.3	100.9	22.5	13.7	2.0	1.7	18.7	11.0	3.5	5.4	0.2	0.3	0.2	0.4	9.5	13.2
CSPs	Amazon	2,674.7	0.4	8.6	14.0	17.1	34.3	28.8	26.5	7.1	5.7	16.4	13.7	713.5	793.2	80.5	100.3	166.7	202.3	22.3	19.7
	Microsoft	3,769.4	-1.4	-6.4	-2.0	-3.9	16.3	33.5	29.3												

Amkor Technology 관련 용어

용어	이미지	설명
SiP (System in Package)		시스템의 전체나 일부의 집적 회로들을 하나의 패키지로 묶는 기술
AiP/AoP (Antenna in/on Package)		안테나를 패키지 내부에 통합하는 기술
SCSP (Stacked Chip Scale Package)		여러 개의 칩을 수직으로 쌓아 통합한 반도체 패키징 기술
Lead Frame		반도체 칩과 외부 회로를 연결하는 전선 역할과 배대 역할을 동시에 수행하는 부품
Fan Out		배선과 솔더 볼 등을 칩 사이즈 밖에 배치하여 패키징 하는 공정
Flip Chip		반도체 칩과 회로 기판을 부착할 때, 칩 하단의 전극 패턴을 이용해 용착하는 기술
ADAS (Advanced Driver Assistance System)		차량 센서와 카메라 등을 활용하여 운전을 지원하는 기술 시스템
SiC (Silicon Carbide)		실리콘(Si)과 탄소(C)의 강한 공유 결합으로 이뤄진 화합물 반도체 소재
GaN (Gallium Nitride)		질소(N)와 갈륨(Ga)의 화합물로, 실리콘 대비 녹는 점이 높아 안정성이 우수한 반도체 소재
Chip on Chip		단일 기판에 여러 다이를 전기적으로 연결하는 패키징 기술
Package on Package		두 개 이상의 반도체 패키지를 수직으로 쌓는 패키징 기술
Infotainment		자동차나 스마트 기기 등에서 사용자에게 정보와 오락 기능을 제공하는 시스템
Microcontrollers		프로세서, 메모리 등을 하나의 칩에 집적한 소형 컴퓨터

자료: Amkor Technology, SEMI Korea, 삼성전자, 키움증권 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.